

肖特玻璃基板

用于先进半导体封装

探索玻璃在先进集成电路载板和中介层中的优势：

玻璃凭借其精确定制的热膨胀系数（CTE）、高刚性、优异的电学性能、卓越的热稳定性以及超平滑表面，使其实现了高密度互连和先进异质封装。其精密可结构化性使得精细线路光刻、形成最佳通孔以及薄型封装中的热管理优化成为可能。

肖特提供全面的可定制玻璃解决方案组合，专门应对行业挑战性趋势，例如 数据传输速率提升、I/O 密度增长、载板尺寸增大，以及共封装光学等新一代技术的涌现。作为高性价比材料，玻璃正迅速成为尖端集成电路和微电子封装的首选材料。

为什么选择肖特玻璃基板？

高度多样性
得益于一系列具有不同热膨胀系数（CTE）的玻璃类型，我们的玻璃基板可为 IC 和 RF 基板设计以及系统级封装实现最佳的封装性能。

多种形式
提供多种玻璃尺寸，最大可达 650 × 650 mm 的基板 – 其中包括 510 × 515 mm – 并提供不同厚度的选择。

高刚性
减少封装翘曲，保持较大芯片和封装单元的完整性与性能。

高精度
我们的基板具有高几何精度和表面质量，边缘经过精密加工处理。

优异的介电性能
低损耗因子可实现高效的天线以及具有极低信号延迟的封装。

适用于先进结构化加工
在超精细、高密度的 TGV（通孔）激光加工方面表现卓越，我们的玻璃面板能够轻松适应复杂设计，并实现机械性能稳定的开槽结构，适用于元件嵌入。

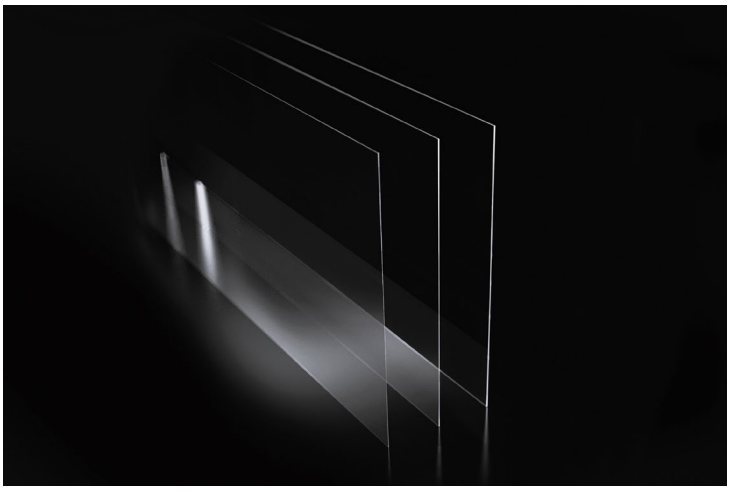
SCHOTT

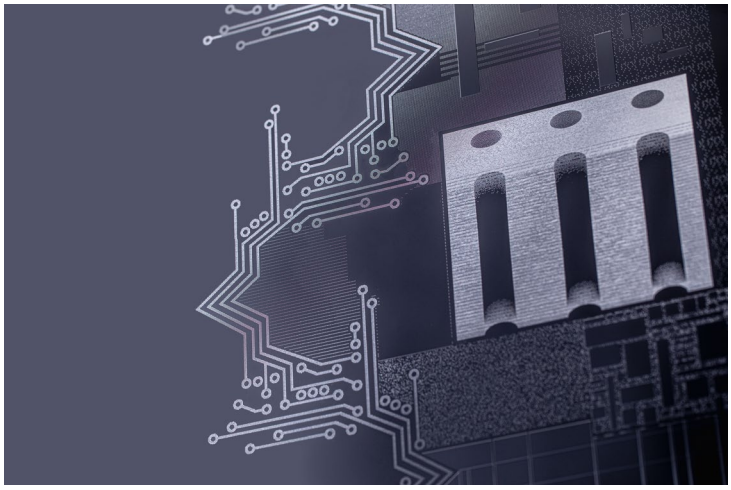
玻璃基板

用于先进半导体封装的卓越性能

属性	目标规格[1]
CTE 范围 (20 – 300 °C)	3.2 – 7.2 ppm/K
尺寸	最大值: 650 x 650 毫米[2]
厚度[3]	0.25 – 2.0 毫米
厚度公差[3]	± 15 – 20 µm
总厚度变化 (TTV)[3]	⩽ 10 – 20 µm
翘曲[3]	⩽ 100 – 200 µm
划伤/凹坑 (Scratch/Dig)	40/20
边缘缺陷	⩽ 100 – 200 µm
边缘处理	圆形或倒角研磨

(1) 可根据要求提供更严格的规格
(2) 标准尺寸: 515 × 510 毫米
(3) 典型数值，具体取决于玻璃类型和厚度



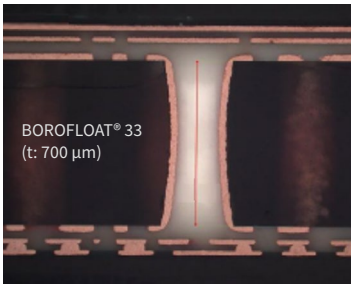


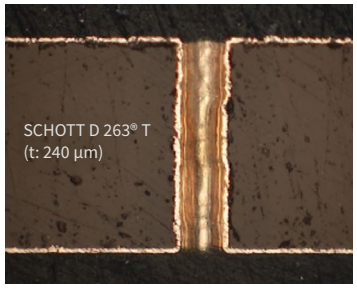
介绍肖特的样品方案: 高精度结构化加工

源自肖特在传感与成像应用领域丰富的激光结构化加工经验，我们推出FLEXINITY® 解决方案，助力客户开展研发项目。FLEXINITY® 不仅能够实现超高精度，高密度TGV通孔布局，还可将用于嵌入主动和被动元件的大尺寸开槽集成于一体。

探索我们的应用支持: 高性能金属化

肖特玻璃可在多种工艺条件下实现表面与通孔的完美金属化处理。凭借我们广泛的合作伙伴网络，可对多种类型的玻璃基板进行金属化加工，包括SCHOTT D 263® T、BOROFLOAT® 33及SCHOTT® AF 35 G，尺寸可达515毫米×510毫米，实现超过5:1的深宽比，粘结强度范围为500至1500牛顿/米以上，同时支持填实和保形的金属化。





CHINESE 07/2026 kn

schott.com

SCHOTT